

英飞凌 MOSFET

600V CoolMOS™ G7 SJ 功率器件

C7 GOLD 系列 (G7) 首次将 C7 GOLD CoolMOS™ 技术的优势、4 pin 开尔文源功能和 TOLL 封装的改进热特性相结合，从而为大电流拓扑（如最高 3kW 的 PFC）提供了可能的 SMD 解决方案

特性

- C7 Gold 可提供业界领先的 FOM $R_{DS(on)} * E_{oss}$ 和 $R_{DS(on)} * Q_g$
- 适用于硬开关和软开关（PFC 和高性能 LLC）
- C7 Gold 技术可在最小尺寸内实现业界领先的 $R_{DS(on)}$
- TOLL 封装具有内置 4 pin 开尔文源配置和低寄生源电感（~1nH）。
- TOLL 封装符合 MSL1 标准，完全无铅设计，具有便于目视检查的沟槽引线
- TOLL SMD 封装与无铅芯片工艺相结合，提高了热性能 R_{th} 。

优点

- C7 Gold FOM $R_{DS(on)} * Q_g$ 比前代 C7 600V 高 15%，开关速度更快，效率更高。
- 通过应用中使用 PFC 和 PWM 拓扑，提高经济效益
- C7 Gold 在 TOLL 115 平方毫米的封装尺寸下可达到 28mΩ，而以前的 BIC C7 600V 在 150 平方毫米的 D²PAK 封装尺寸下可达到 40mΩ。
- 通过开尔文源极降低寄生源极电感，提高了开关速度，减少了振铃，从而提高了效率。
- TOLL 封装易于使用，具有最高的质量标准。
- 改进的散热性能使 SMD TOLL 封装能够用于比以往电流更高的设计中。

潜在应用

适用于高功率/高性能 SMPS 的 PFC 和 PWM（TTF、LLC），例如计算、服务器、通信、不间断电源和光伏行业。

产品验证

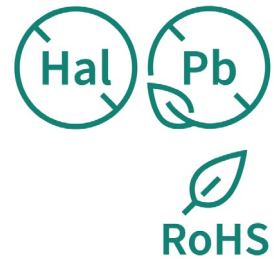
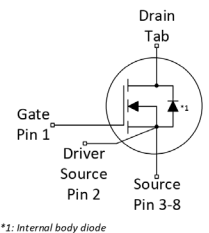
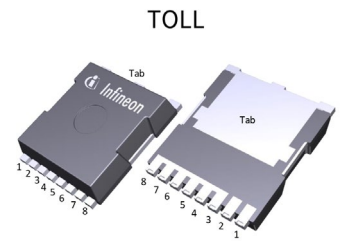
完全符合 JEDEC 工业应用标准

请注意：对于 MOSFET 并联，通常建议在栅极上使用铁氧体磁珠或单独的图腾柱。

表 1 主要性能参数

Parameter	Value	Unit
$V_{DS} @ T_{j,max}$	650	V
$R_{DS(on),max}$	28	mΩ
$Q_{g,typ}$	123	nC
$I_{D,pulse}$	245	A
$I_{D,continuous} @ T_j < 150^{\circ}C$	87	A
$E_{oss}@400V$	14.7	μJ
Body diode di/dt	1000	A/μs

Part number	Package	Marking	Related links
IPT60R028G7	PG-HSOF-8	60R028G7	see Appendix A



目录

描述.....	1
最大额定值.....	3
热特性.....	4
电气特性.....	5
电气特性图.....	7
测试电路.....	11
封装外形.....	12
附录 A.....	15
修订记录.....	16
商标.....	17
免责声明.....	17

1 最大额定值

$T_f=25\text{ °C}$, 除非另有规定

Table 2 最大额定值

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Continuous drain current ¹⁾	I_D	-	-	75	A	$T_C=25\text{ °C}$
				47		$T_C=100\text{ °C}$
Pulsed drain current ²⁾	$I_{D,pulse}$	-	-	245	A	$T_C=25\text{ °C}$
Avalanche energy, single pulse	E_{AS}	-	-	288	mJ	$I_D=7.7\text{ A}; V_{DD}=50\text{ V};$ see table 10
Avalanche energy, repetitive	E_{AR}	-	-	1.44		
Avalanche current, single pulse	I_{AS}	-	-	7.7	A	-
MOSFET dv/dt ruggedness	dv/dt	-	-	120	V/ns	$V_{DS}=0\dots400\text{ V}$
Gate source voltage (static)	V_{GS}	-20	-	20	V	static;
Gate source voltage (dynamic)	V_{GS}	-30	-	30	V	AC ($f>1\text{ Hz}$)
Power dissipation	P_{tot}	-	-	391	W	$T_C=25\text{ °C}$
Storage temperature	T_{stg}	-55	-	150	°C	-
Operating junction temperature	T_j	-55		150	°C	
Mounting torque	-	-		n.a.	Ncm	
Continuous diode forward current	I_S	-	-	75	A	$T_C=25\text{ °C}$
Diode pulse current ²⁾	$I_{S,pulse}$	-	-	245		
Reverse diode dv/dt ³⁾	dv/dt	-	-	25	V/ns	$V_{DS}=0\dots400\text{ V}, I_{SD}\leq 11.8\text{ A}, T_j=25\text{ °C}$ see table 8
Maximum diode commutation speed	di_t/dt	-	-	1000	A/ μs	
Insulation withstand voltage	V_{ISO}	-	-	n.a.	V	$V_{rms}, T_C=25\text{ °C}, t=1\text{ min}$

1) 受限于 $T_{j,max}$

2) 脉冲宽度 t_p 受限于 $T_{j,max}$

3) 相同的低边和高边开关

2 热特性

表 3 热特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Thermal resistance, junction - case	R_{thJC}	-	-	0.32	°C/W	-
Thermal resistance, junction - ambient	R_{thJA}	-	-	62	°C/W	device on PCB, minimal footprint
Thermal resistance, junction - ambient for SMD version	R_{thJA}	-	35	45	°C/W	Device on 40mm*40mm*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm ² (one layer, 70µm thickness) copper area for drain connection and cooling. PCB is vertical without air stream cooling.
Soldering temperature, wave- & reflow soldering allowed	T_{sold}	-	-	260	°C	reflow MSL1

3 电气特性

$T_j=25\text{ }^\circ\text{C}$, 除非另有规定

表 4 静态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Drain-source breakdown voltage	$V_{(BR)DSS}$	600	-	-	V	$V_{GS}=0V, I_D=1mA$
Gate threshold voltage	$V_{(GS)th}$	3	3.5	4	V	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=1.44mA$
Zero gate voltage drain current	I_{DSS}	-	-	1	μA	$V_{DS}=600, V_{GS}=0V, T_j=25^\circ C$
			10	-		$V_{DS}=600, V_{GS}=0V, T_j=150^\circ C$
Gate-source leakage current	I_{GSS}	-	-	100	nA	$V_{GS}=20V, V_{DS}=0V$
Drain-source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	-	0.024	0.028	Ω	$V_{GS}=10V, I_D=28.8A, T_j=25^\circ C$
			0.060	-		$V_{GS}=10V, I_D=28.8A, T_j=150^\circ C$
Gate resistance	R_G	-	0.85	-	Ω	$f=1MHz, \text{open drain}$

表 5 动态特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Input capacitance	C_{iss}	-	4820	-	pF	$V_{GS}=0V, V_{DS}=400V, f=250kHz$
Output capacitance	C_{oss}	-	99	-		
Effective output capacitance, energy related ⁴⁾	$C_{o(er)}$	-	184	-	pF	$V_{GS}=0V, V_{DS}=0...400V$
Effective output capacitance, time related ⁵⁾	$C_{o(tr)}$	-	1900	-	pF	$I_D=\text{constant}, V_{GS}=0V, V_{DS}=0...400V$
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	-	28	-	ns	$V_{DD}=400V, V_{GS}=13V, I_D=28.8A, R_G=1.8\Omega; \text{see table 9}$
Rise time	t_r		9			
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		100			
Fall time	t_f		2.8			

4) $C_{o(er)}$ 是一个固定电容, 其储存能量与 C_{oss} 相同, 当 V_{DS} 从 0 上升至 400V

5) $C_{o(tr)}$ 是一个固定电容, 其充电时间与 C_{oss} 相同, 当 V_{DS} 从 0 上升至 400V

表 6 栅极电荷特性

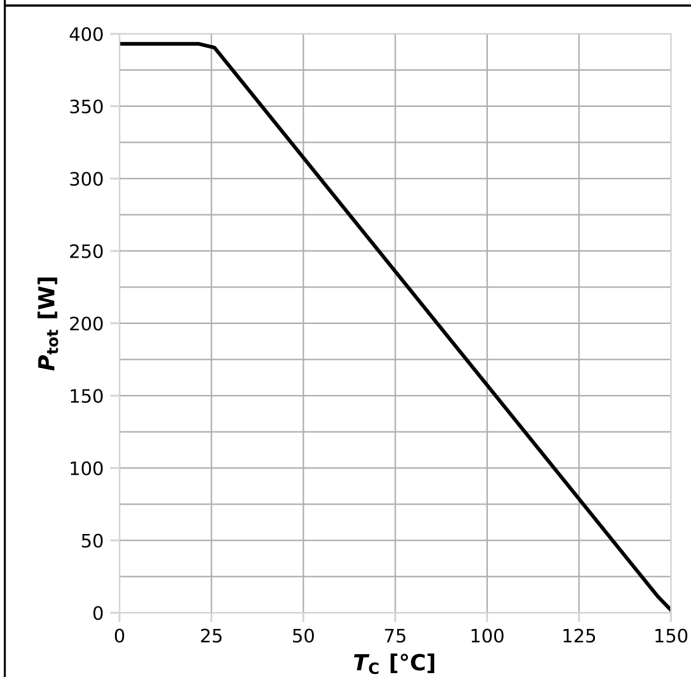
Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Gate to source charge	Q_{gs}	-	24	-	nC	$V_{DD}=400V, I_D=28.8A, V_{GS}=0 \text{ to } 10V$
Gate to drain charge	Q_{gd}		44		nC	
Gate charge total	Q_g		123		nC	
Gate plateau voltage	$V_{plateau}$		5.0		V	

表 7 反向二极管特性

Parameter	Symbol	Values			Unit	Note / Test condition
		Min.	Typ.	Max.		
Diode forward voltage	V_{SD}	-	0.8	-	V	$V_{GS}=0V, I_F=28.8A, T_J=25^\circ C$
Reverse recovery time	t_{rr}	-	440	-	ns	$V_R=400V, I_F=28.8A, di_F/dt=100A/\mu s$; see table 8
Reverse recovery charge	Q_{rr}		8.7		μC	
Peak reverse recovery current	I_{rrm}		39		A	

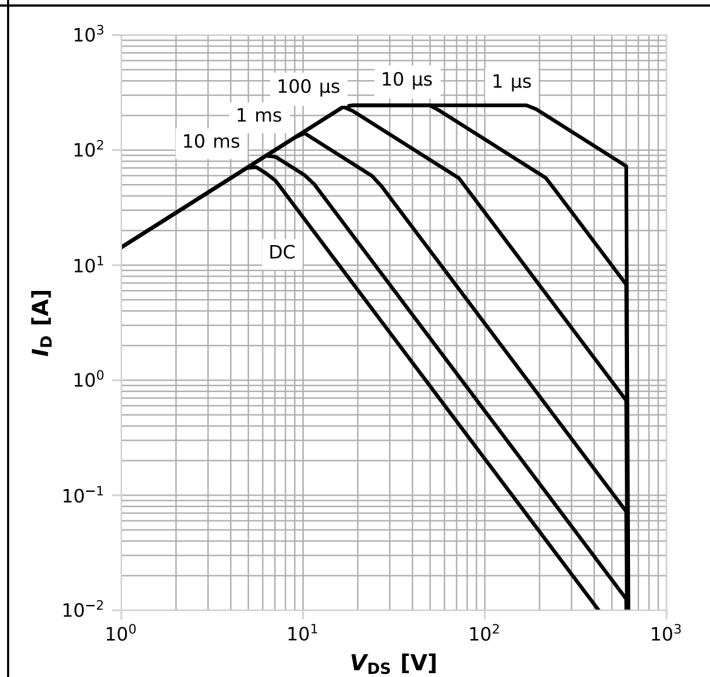
4 电气特性图

Diagram 1: Power dissipation



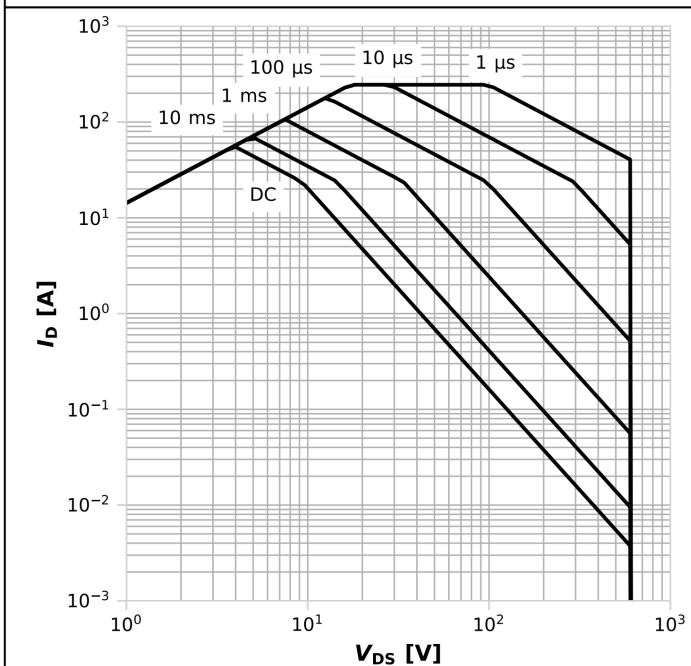
$$P_{\text{tot}} = f(T_c)$$

Diagram 2: Safe operating area



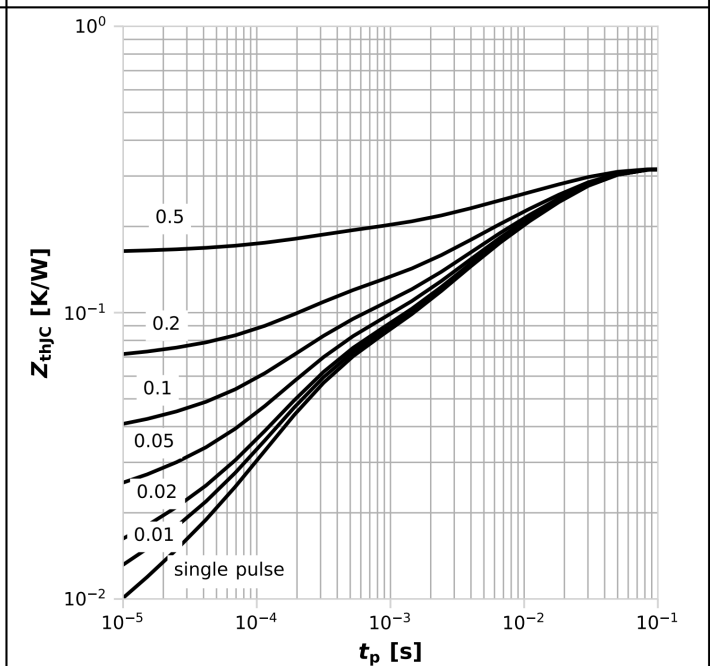
$$I_D = f(V_{DS}); T_c = 25^\circ\text{C}; D = 0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 3: Safe operating area



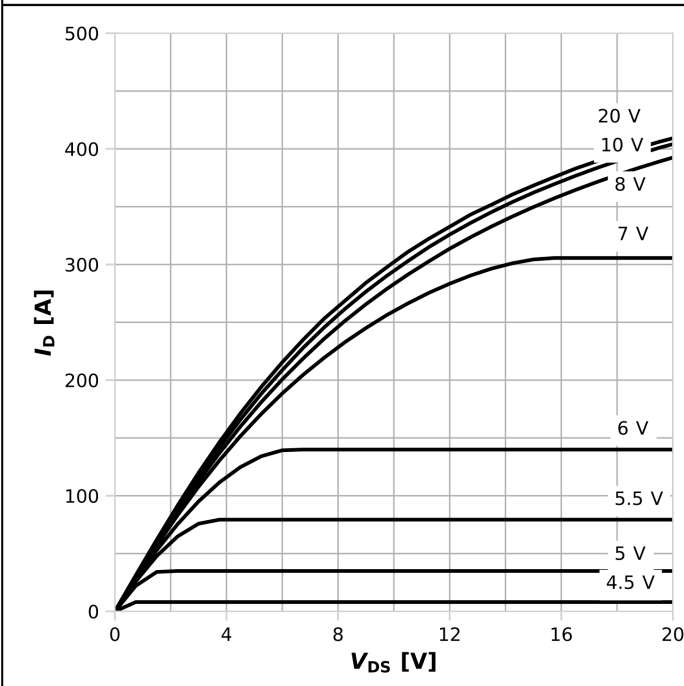
$$I_D = f(V_{DS}); T_c = 80^\circ\text{C}; D = 0; \text{parameter: } t_p$$

Diagram 4: Max. transient thermal impedance



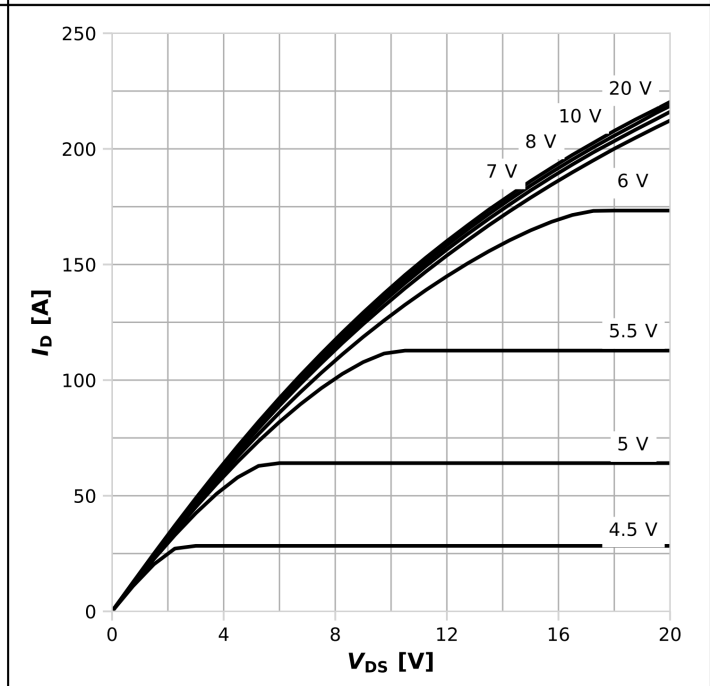
$$Z_{\text{thjC}} = f(t_p); \text{parameter: } D = t_p / T$$

Diagram 5: Typ. output characteristics



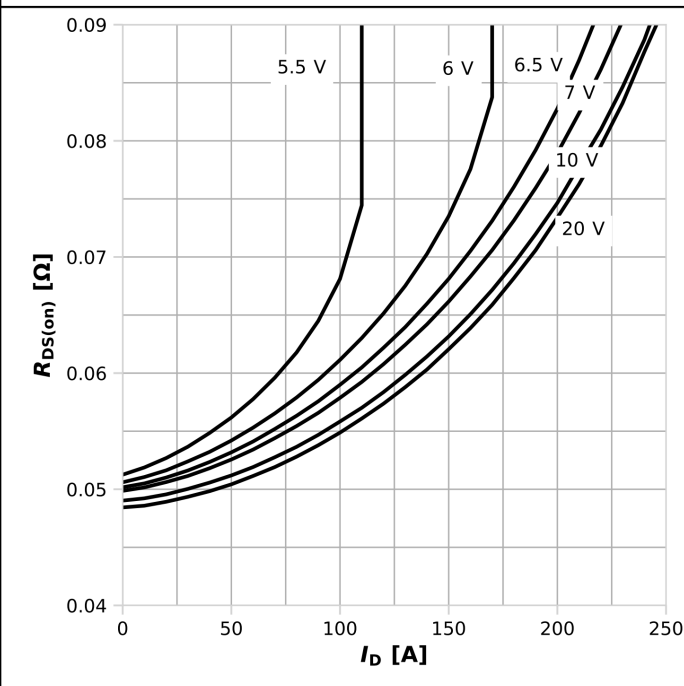
$I_D = f(V_{DS}); T_j = 25\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 6: Typ. output characteristics



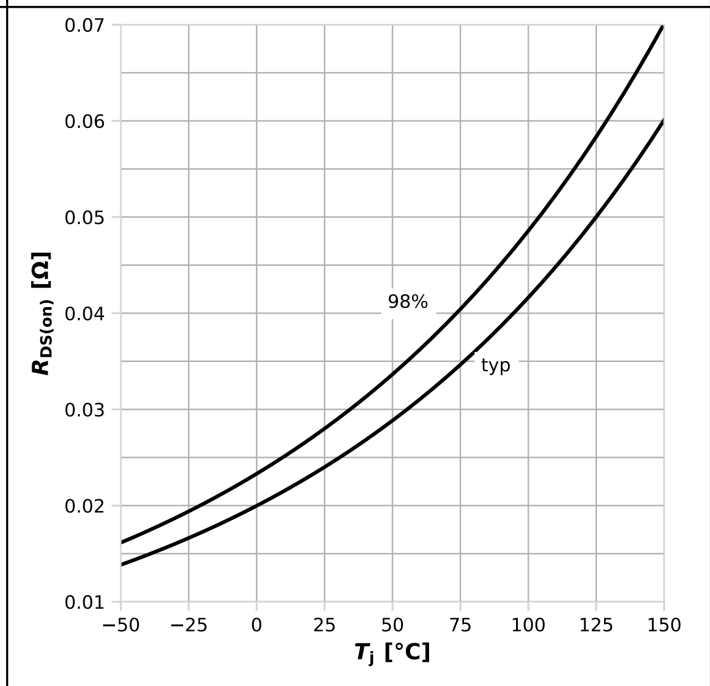
$I_D = f(V_{DS}); T_j = 125\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 7: Typ. drain-source on-state resistance



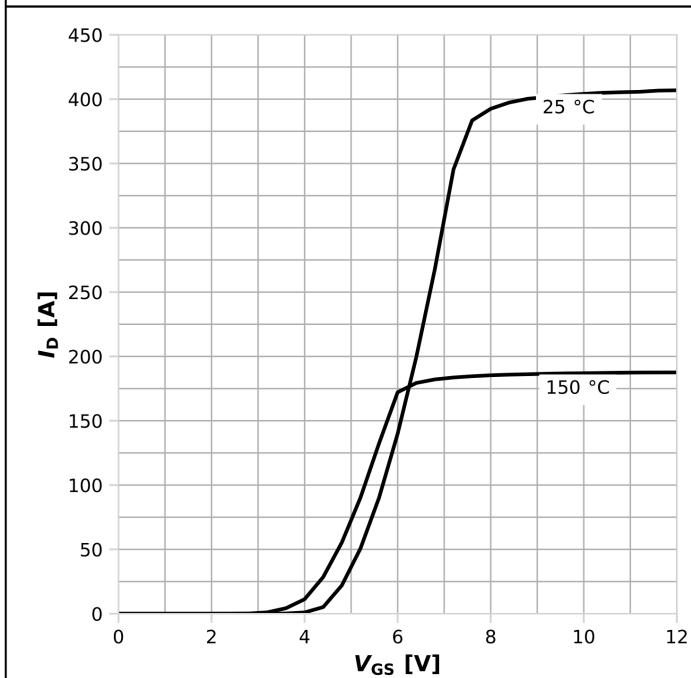
$R_{DS(on)} = f(I_D); T_j = 125\text{ °C}; \text{parameter: } V_{GS}$

Diagram 8: Drain-source on-state resistance



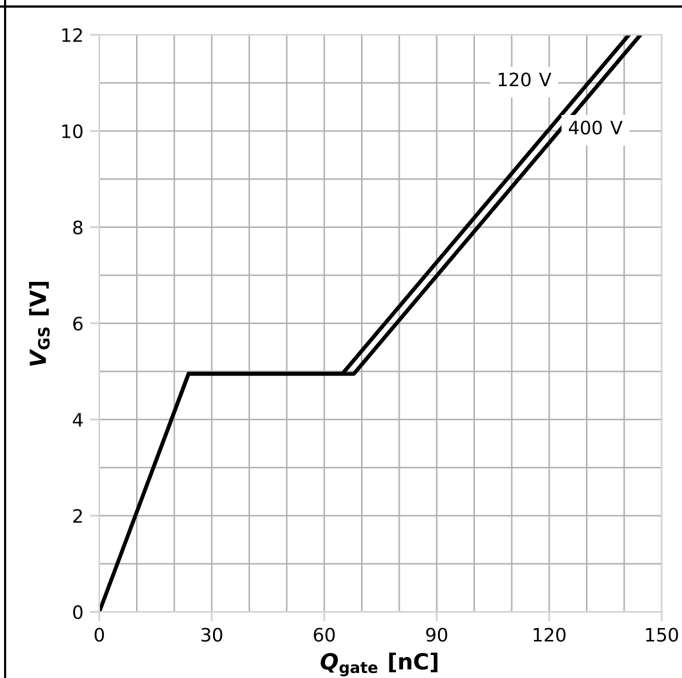
$R_{DS(on)} = f(T_j); I_D = 28.8\text{ A}; V_{GS} = 10\text{ V}$

Diagram 9: Typ. transfer characteristics



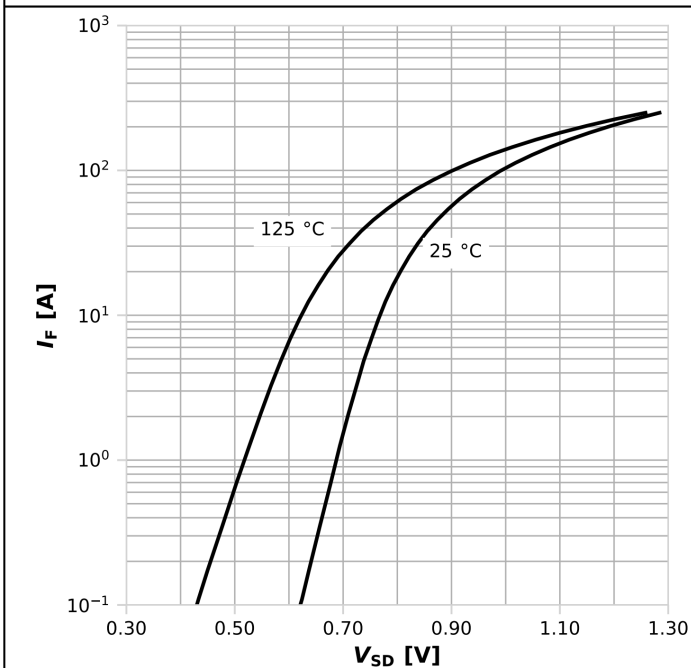
$I_D=f(V_{GS}); V_{DS}=20V; \text{parameter: } T_j$

Diagram 10: Typ. gate charge



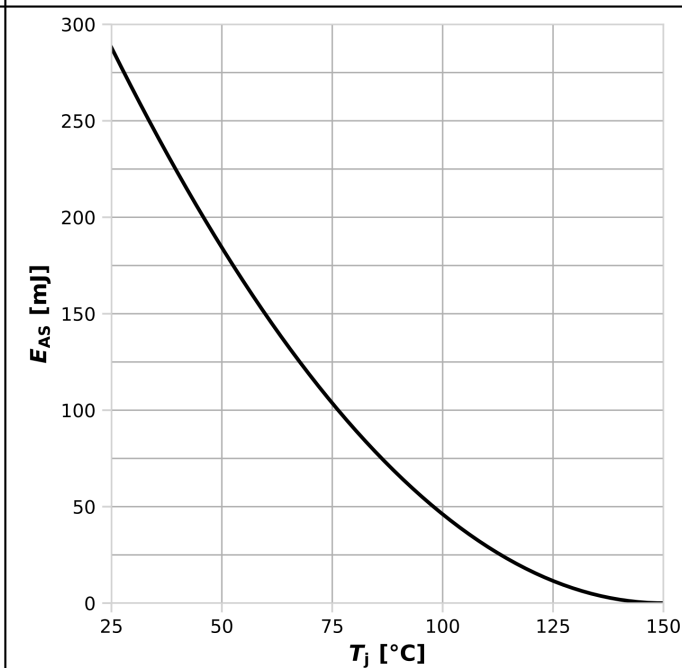
$V_{GS}=f(Q_{gate}); I_D=28.8 \text{ A pulsed}; \text{parameter: } V_{DD}$

Diagram 11: Forward characteristics of reverse diode

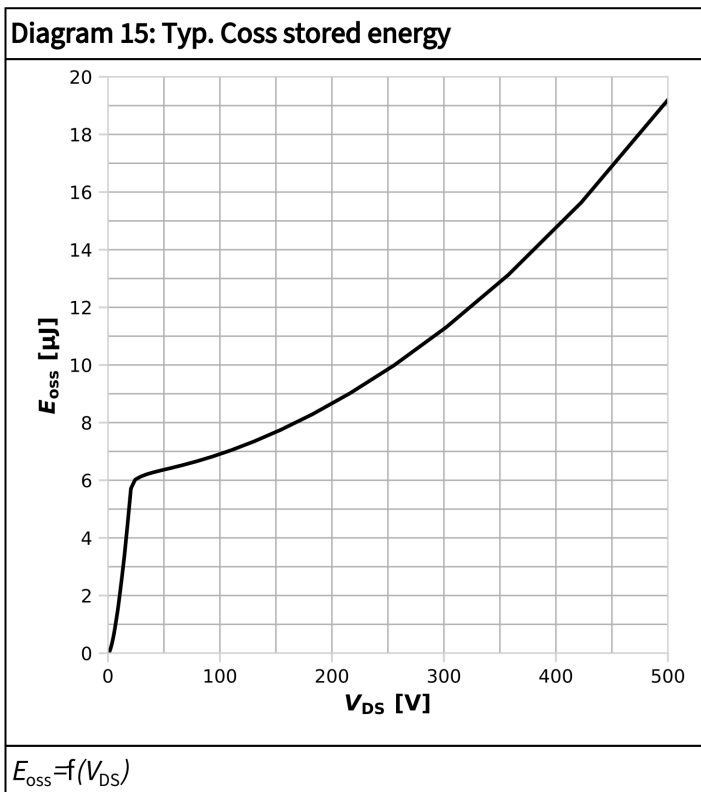
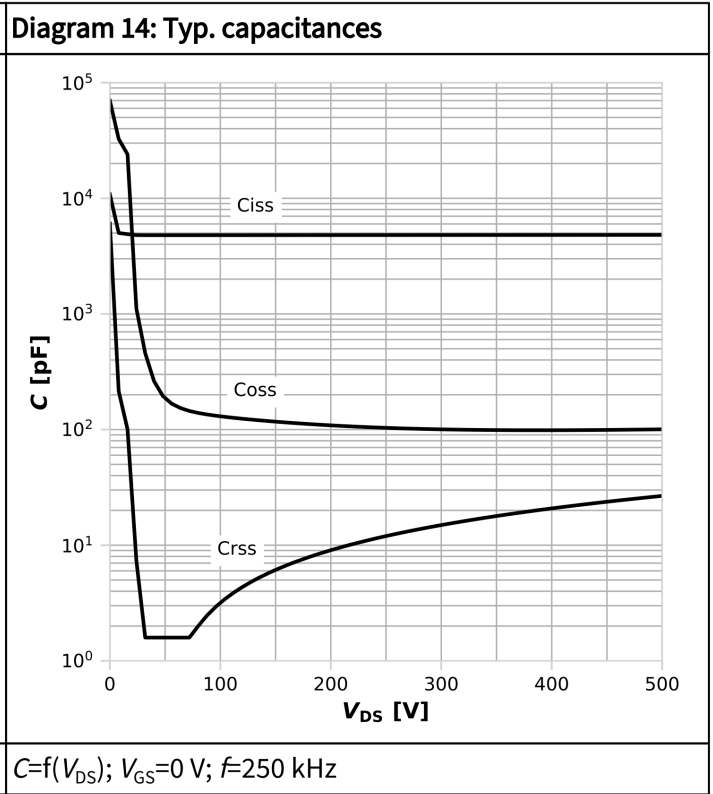
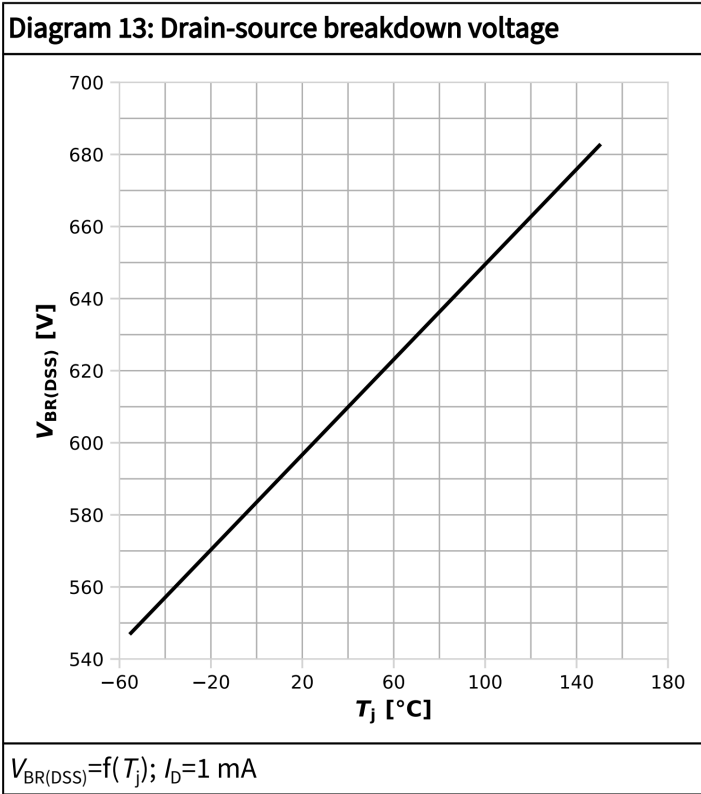


$I_F=f(V_{SD}); \text{parameter: } T_j$

Diagram 12: Avalanche energy



$E_{AS}=f(T_j); I_D=7.7 \text{ A}; V_{DD}=50 \text{ V}$



5 测试电路

表8 二极管特性

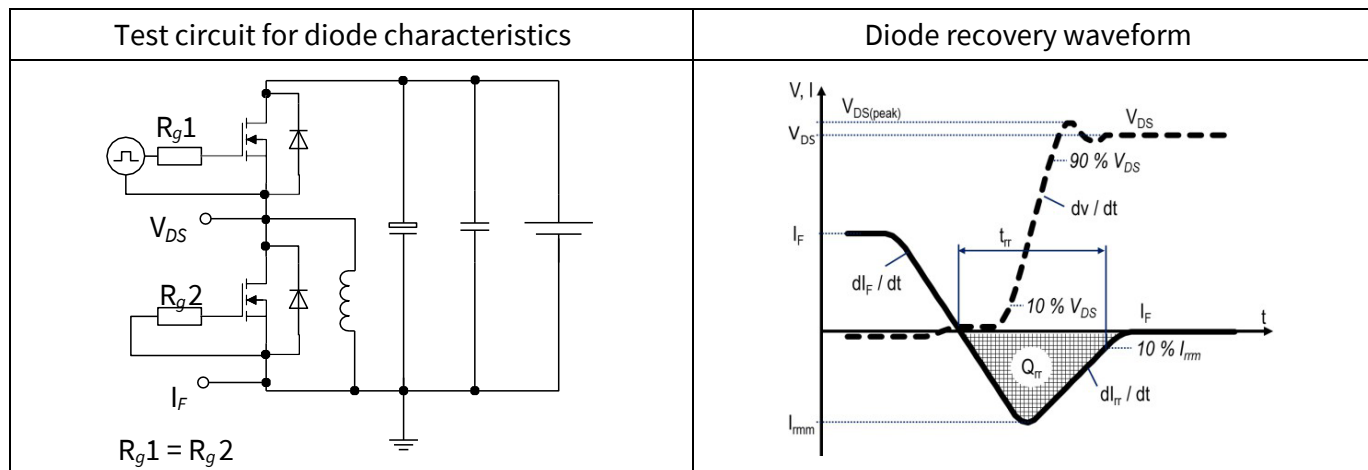


表9 切换时间 (ss)

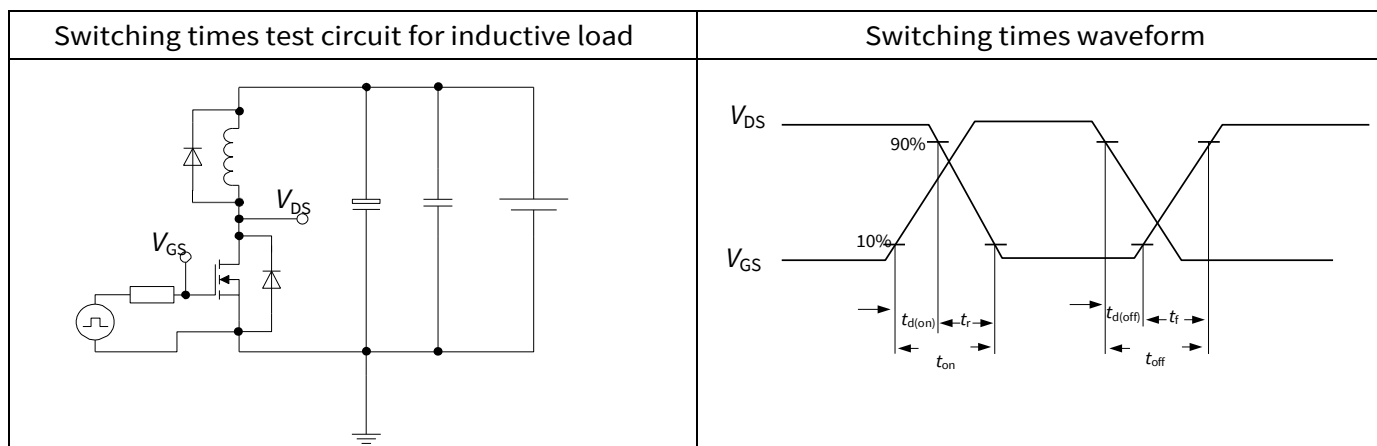
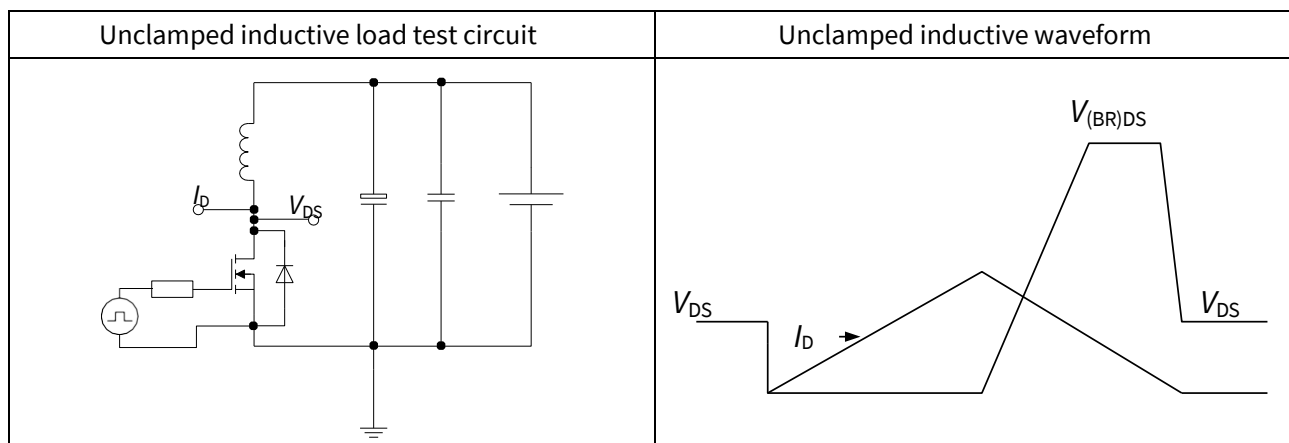
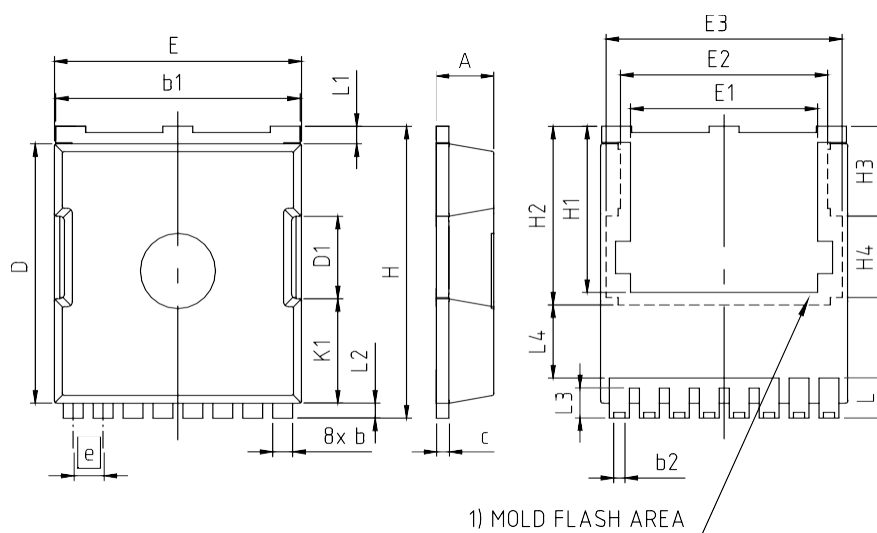


表10 非钳位感性负载 (ss)



6 封装外形



PACKAGE - GROUP NUMBER: PG-HSOF-8-U02		
DIMENSIONS	MILLIMETERS	
	MIN.	MAX.
A	2.20	2.40
b	0.70	0.90
b1	9.70	9.90
b2	0.42	0.50
c	0.40	0.60
D	10.28	10.58
D1	3.30	
E	9.70	10.10
E1	7.50	
E2	8.50	
E3	9.46	
e	1.20 (BSC)	
H	11.48	11.88
H1	6.55	6.95
H2	7.15	
H3	3.59	
H4	3.26	
N	8	
K1	4.18	
L	1.40	1.80
L1	0.50	0.90
L2	0.50	0.70
L3	1.00	1.30
L4	2.62	2.81

1) PARTIALLY COVERED WITH MOLD FLASH

图 1 PG-HSOF-8 外形图，尺寸单位为毫米

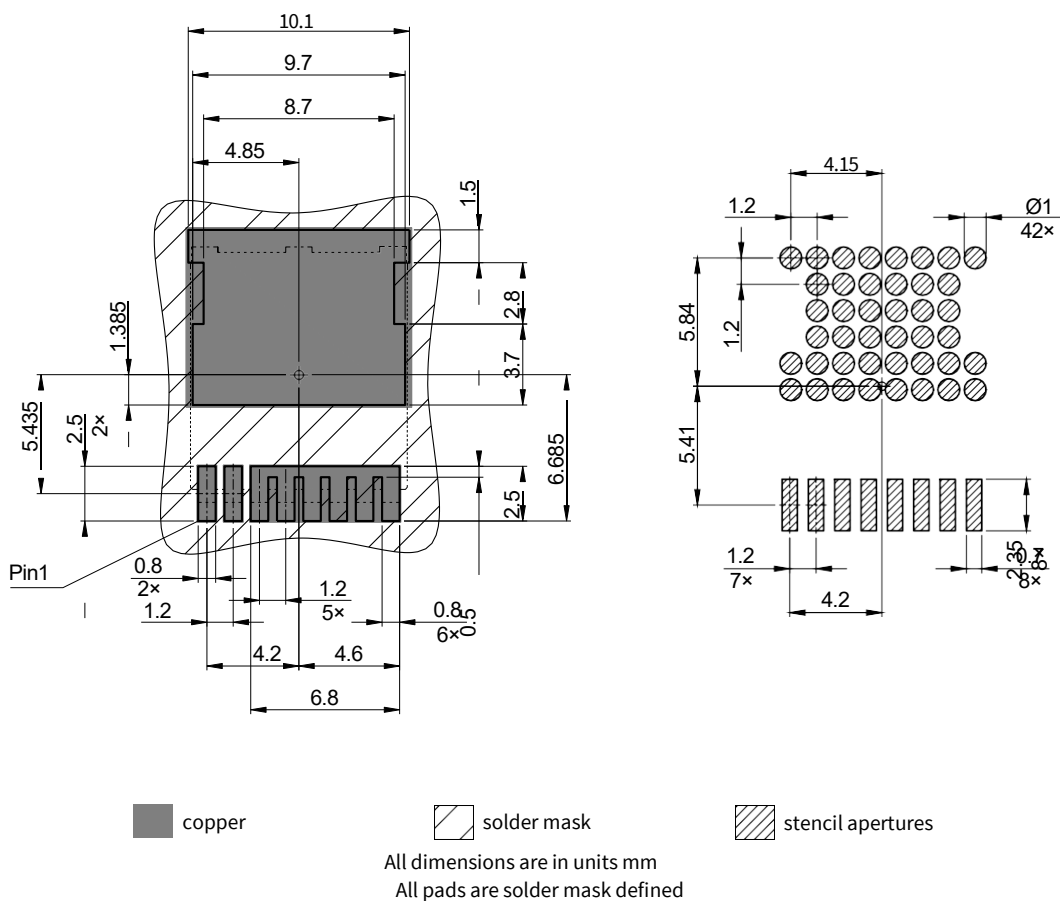
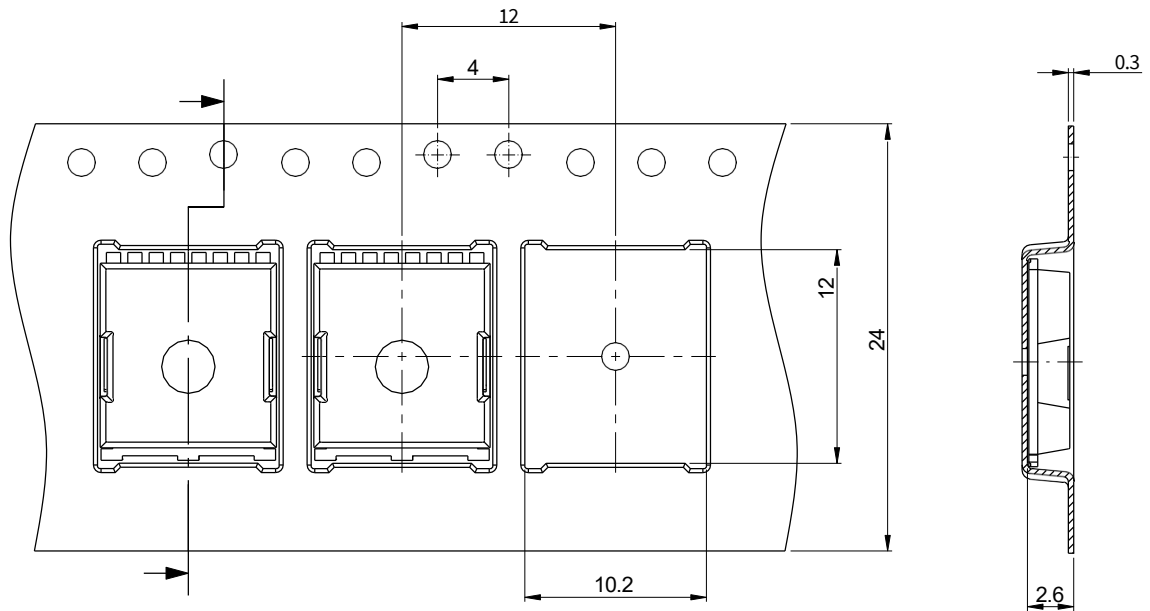


图 2 PG-HSOF-8 封装图，尺寸单位为毫米



All dimensions are in units mm
The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 []

图 3 PG-HSOF-8 包装型号，尺寸单位为毫米

7 附录 A

表 11 相关链接

- [IFX CoolMOS™ G7 网页](#)
- [IFX CoolMOS™ G7 应用笔记](#)
- [IFX CoolMOS™ G7 仿真模型](#)
- [IFX 设计工具](#)

修订记录

IPT60R028G7

Revision 2025 - 02 - 03 , Rev. 2 . 2

历史修订版本

Revision	Date	Subjects (major changes since last revision)
2.0	2016-12-15	Release of final version
2.1	2020-10-27	Content update diagram 2,3,4,7,8 and format update
2.2	2025-02-03	Implementation of standardized Infineon Umbrella-Templates for package drawings. H1 Extension from 6.75 to 6.95 MAX



免责声明

请注意，本文件的原文使用英文撰写，为方便客户浏览英飞凌提供了中文译文。该中文译文仅供参考，并不可作为任何论点之依据。

由于翻译过程中可能使用了自动化程序，以及语言翻译和转换过程中的差异，最后的中文译文与最新的英文版本原文含义可能存在不尽相同之处。

因此，我们同时提供该中文译文版本的最新英文原文供您阅读，请参见 <http://www.infineon.com>

英文原文和中文译文版本之间若存有任何歧异，以最新的英文版本为准，并且仅认可英文版本为正式文件。

您如果使用本文件，即表示您同意并理解上述说明。英飞凌不对因翻译过程中可能存在的任何不完整或不准确信息而产生的任何直接或间接损失或损害负责。英飞凌不承担中文译文版本的完整性和准确性责任。如果您不同意上述说明，请不要使用本文件。

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

重要通知

版本 2026-03-30

Infineon Technologies AG 出版，
德国 Neubiberg 85579

版权 © 2026 Infineon Technologies AG
及其关联公司。
保留所有权利。

Do you have a question about this
document?

Email:

erratum@infineon.com

Infineon Technologies AG 及其关联公司（以下简称“英飞凌”）销售或提供和交付的产品（可能也包括样品，且可能由硬件或软件或两者组成）（以下简称“产品”），应遵守客户与英飞凌签订的框架供应合同或其他书面协议的条款和条件，如无上合同或其他书面协议，则应遵守适用的英飞凌销售条件。只有在英飞凌明确书面同意的情况下，客户的一般条款和条件或对适用的英飞凌销售条件的偏离才对英飞凌具有约束力。

为避免疑义，英飞凌不承担侵犯第三方权利的所有保证和默示保证，例如对特定用途/目的的适用性或适销性的保证。

英飞凌对与样品、应用或客户对任何产品的具体使用有关的任何信息或本文件中给出的任何示例或典型值概不负责。

本文件中包含的数据仅供具有技术资格和技能的客户代表使用。客户有责任评估产品对预期应用和客户特定用途的适用性，并在预期应用和客户特定用途中验证本文件中包含的所有相关技术数据。客户有责任正确设计、编程和测试预期应用的功能性和安全性，并遵守与其使用相关的法律要求。

除非英飞凌另行明确批准，否则产品不得用于任何因产品故障或使用产品的任何后果可合理预期会导致人身伤害的应用。但是，上述规定并不妨碍客户在英飞凌明确设计和销售的使用领域中使用任何产品，但是客户对应用负有全部责任。

英飞凌明确保留根据适用法律，如《德国版权法》（UrhG）第 44b 条，将其内容用于商业资料和数据探勘（TDM）的权利。

如果产品包含安全功能：

由于任何计算设备都不可能绝对安全，尽管产品采取了安全措施，但英飞凌不保证产品不会被入侵、数据不会被盗或遗失，或不会发生其他漏洞（以下简称“安全漏洞”），英飞凌对任何安全漏洞不承担任何责任。

如果本文件包含或引用软件：

根据美国、德国和世界其他国家的知识产权法律和条约，该软件归英飞凌所有。英飞凌保留所有权利。因此，您只能按照软件附带的软件授权协议的规定使用本软件。

如果没有适用的软件授权协议，英飞凌特此授予您个人的、非排他性的、不可转让的软件知识产权授权（无权转授权）：(a) 对于以源代码形式提供的软件，仅在贵组织内部修改和复制该软件用于英飞凌硬件产品；及 (b) 对于以二进制代码 (binary code) 形式对外向终端用户分发该软件，仅得用于英飞凌硬件产品。禁止对本软件进行任何其他使用、复制、修改、翻译或编译。有关产品、技术、交货条款和条件以及价格的详细信息，请联系离您最近的英飞凌办公室或访问 <https://www.infineon.com>。